

# 第5回(平成26年度 第1回) 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時:平成26年 5月 20日(火) 10:30~16:30

場所:自動車会館 大会議室(2F) (東京都千代田区)

時間	題目	講演者
	司会 西川 宏(大阪大学)	
10:30~ 12:00	『IMS(Injection Molded Solder)技術を用いた 微細はんだバンピング』 (45分)	日本アイ・ビー・エム(株) ○青木 豊広、鳥山 和重、森 裕幸 折井 靖光
	『高電流密度に対応するCu-Cuダイレクト接合の 低温化技術』 (45分)	(株)富士通研究所 ○酒井 泰治、宮島 豊生、今泉 延弘
12:00~ 13:00	昼食休憩	
13:00~ 13:10	委員会議事	
	司会 一山 靖友(日鉄住金テクノロジー(株))	
13:10~ 14:40	Mate2014技術開発論文賞 受賞講演 『高分子複合材料におけるフィラの立体的な 分散把握による界面熱抵抗の定量化と 熱伝導率予測』(45分)	(株)デンソー ○荒尾 修、新帯 亮、杉浦 昭夫
	Mate2014開発奨励賞 受賞講演 『高温動作SiC素子実装のための 金系はんだの融点制御技術』(45分)	○高橋 弘樹 <sup>*1*2</sup> , 村上 善則 <sup>*1*3</sup> , 安在 岳士 <sup>*1*4</sup> , 加藤 史樹 <sup>*1*5</sup> , 渡辺 衣世 <sup>*1</sup> , 佐藤 伸二 <sup>*1*6</sup> , 谷澤 秀和 <sup>*1*6</sup> , 樋山 浩平 <sup>*1*7</sup> , 佐藤 弘 <sup>*1*5</sup> <sup>*1</sup> 技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開 発機構, <sup>*2</sup> 富士電機(株), <sup>*3</sup> 日産自動車(株), <sup>*4</sup> カルソ ニックンセイ(株), <sup>*5</sup> (独)産業技術総合研究所, <sup>*6</sup> サンケン 電気(株), <sup>*7</sup> (株)東芝
	休憩(10分)	
	司会 尾形 繁行(長野沖電気(株))	
14:50~ 16:15	Mate2014開発奨励賞 受賞講演 『ポッティング封止型パワー半導体パッケージの 開発』(45分)	三菱電機(株) ○小川 翔平、藤野 純司、菊池 正雄
	Mate2014優秀発表賞 受賞講演 『短繊維強化樹脂材料の機械的特性に及ぼす 繊維方向および温度の影響』(20分)	群馬大学 ○高橋 諒伍、荘司 郁夫、 (株)山田製作所 関 祐貴、丸山 敏
	Mate2014優秀発表賞 受賞講演 『Sn-Ag-Cu微小接合部における 連続動的再結晶と低サイクル疲労損傷』(20分)	芝浦工業大学 ○文倉 智也、紺谷 洋之、荻谷 義治
16:15~ 16:30	表彰式	

( )内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。